

定穎投控2024年第二季 營運成果報告

Aug. 8, 2024



1. 市場資訊
2. 2024年第二季營運概況
3. 未來展望
4. 定穎在ESG的作為

免責聲明

- 除歷史事件之陳述外，本簡報中前瞻性的敘述因受制於未知風險及不確定性，可能導致實際營運結果與該前瞻性敘述產生重大差異。
- 本簡報中前瞻性的敘述，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整，本公司不負責隨時提醒或更新。

市場資訊

2024 電子市場和印刷電路板市場

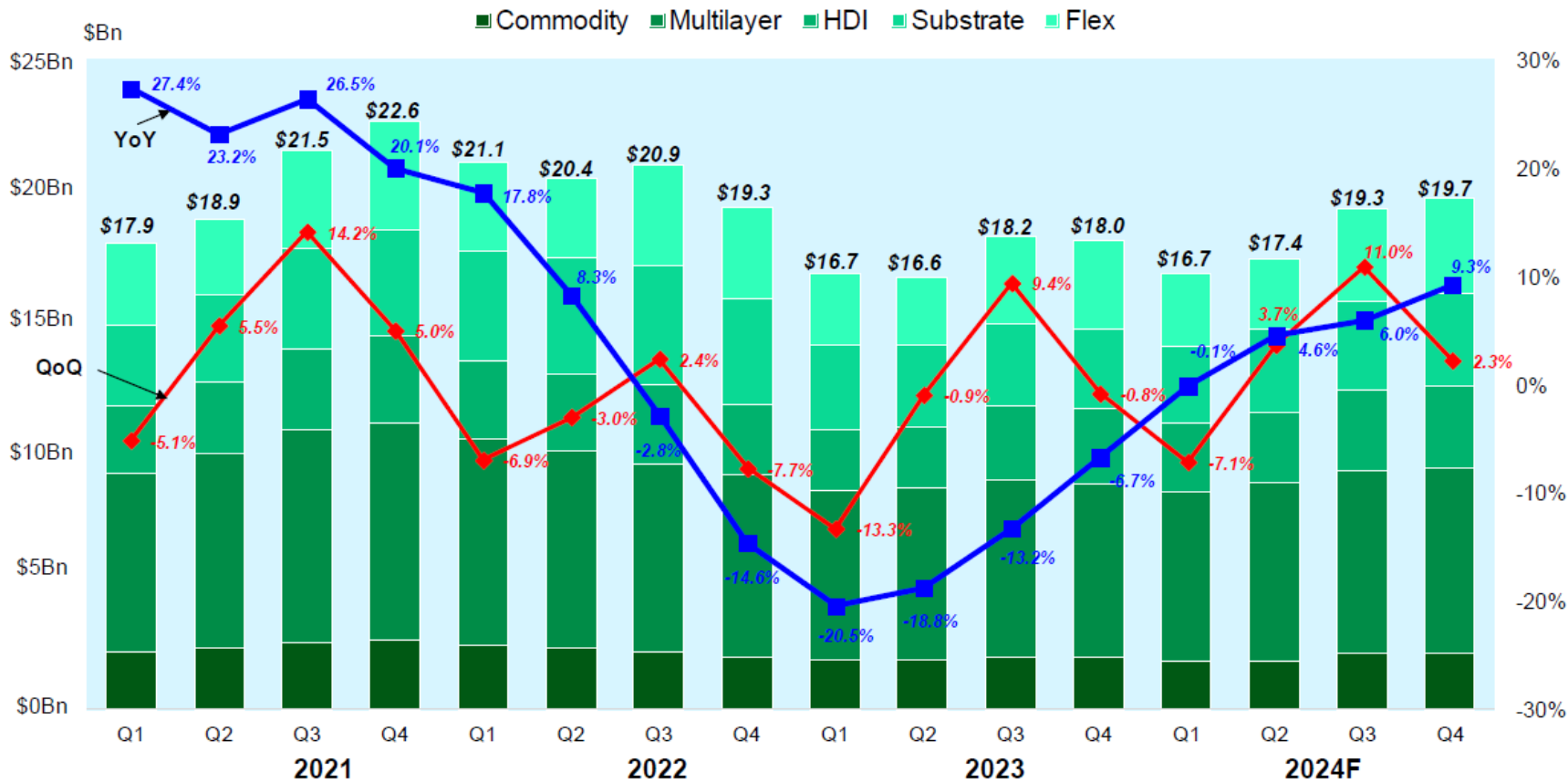
2024電子市場

- 復甦以人工智慧為中心，包括伺服器、高效能運算、網路、先進封裝、高速印刷電路板和材料。
- 電動車、自動駕駛和軍事應用也有助於市場成長。
- 印刷電路板和基板業務在東南亞（包括泰國、馬來西亞和越南）的新啟動，標誌著電子產業發展的關鍵階段。

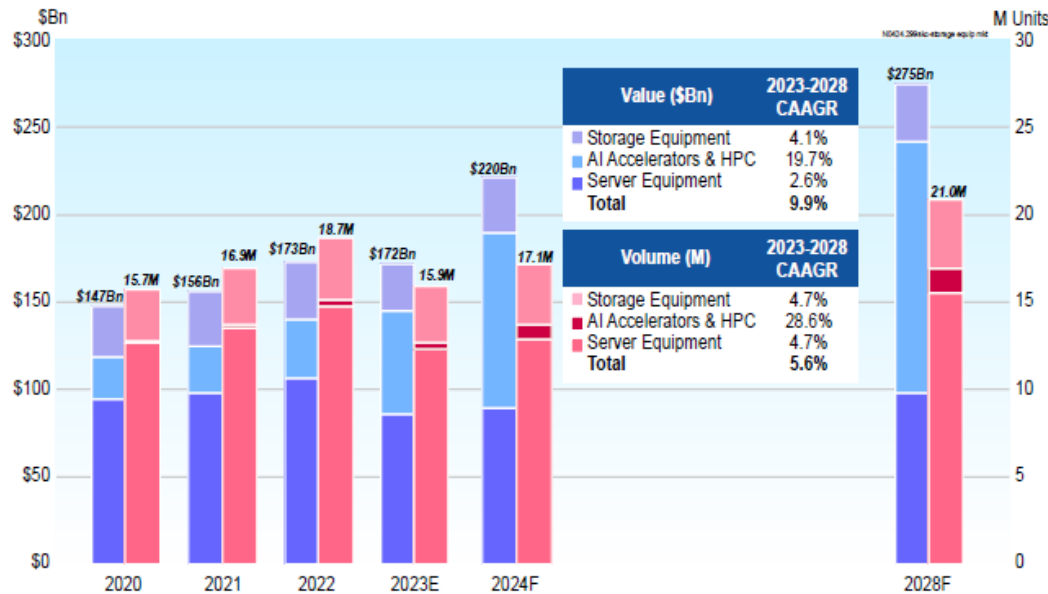
2024年印刷電路板市場預測與展望

- 目前預期印刷電路板市場成長5.0%。
- HDI(高密度連結)成長5.3%，來自人工智慧、光模組、衛星、汽車等應用。
- 多層板領域預計將成長約4%。
- 供應鏈去風險（脫鉤）將為中國以外的供應商提供機會，特別是在東南亞。

印刷電路板市場 Q/Q 成長



應用於伺服器/儲存/人工智慧的印刷電路板市場

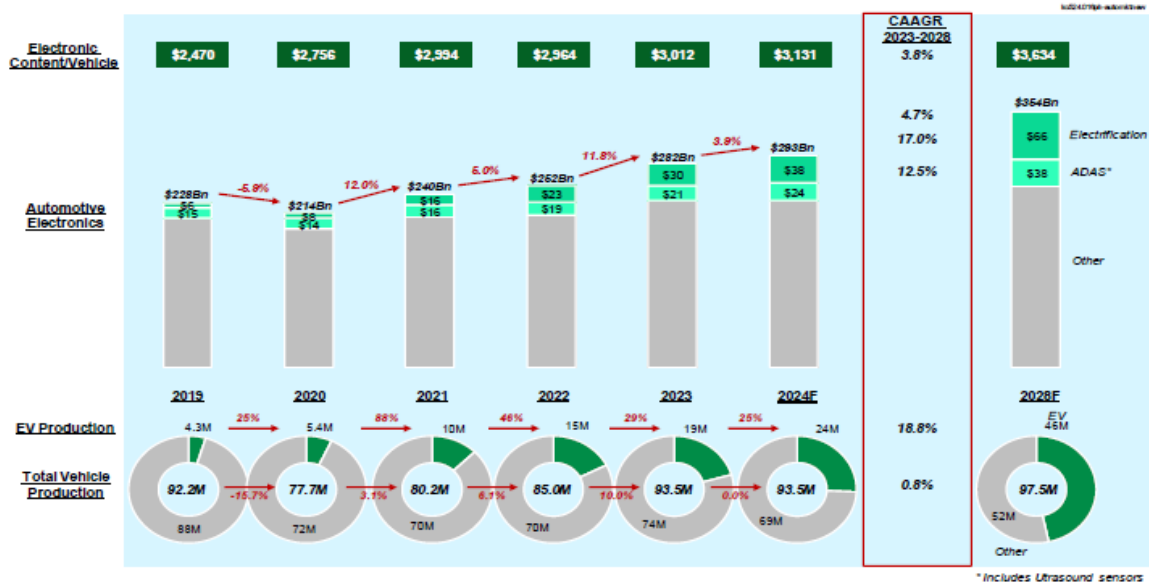


Server/Storage/AI PCB Market

Server PCB Market 2023	\$8.2Bn
2023 - 2028 CAAGR	11.1%
Growth Drivers	Data centers, high-performance computing and AI
Leading Customers	Dell, HP, Inspur, ODM, CSP, Nvidia
Products	High layercount MLB, HDI, FCBGA substrates
Technologies	High-speed laminates, SAP FCBGA

Attribute	Range	Trend for Next 5 years
Layercount	8L for lower end 12-16L higher end rack >22L for Highest complexity	No change in the range, but more pressure to higher layercount
Max Layercount	24 to 28	Modest growth to 30-34
Trace to trace	4 mil → 3.5 mil	
Material Selection	Mid-loss to very-loss laminate Low profile copper required	Higher requirement on electric performance, ultra low-loss, extreme low-loss laminate needed, very-low-profile copper

應用於汽車的印刷電路板市場



Automotive PCB Market	
Automotive PCB Market 2023	\$9.2Bn
2023 – 2028 CAAGR	5.2%
Growth Drivers	EV, ADAS
Leading Customers	Tesla, BYD, Bosch, Denso, Aptiv, etc.
Products	HDI, FPC, Thick Cu and RF ML boards
Technologies	High reliability, special materials

PRISMARK (2024.06.25)

- 產品技術：HDI，10L以上，2階以上，高頻，厚銅
- 產品應用：自動駕駛、ADAS、智慧座艙、車聯網運算、電池管理模組、鏡頭模組等

印刷電路板市場發展趨勢

未來五年，PCB市場規模可能從2023年的695億美元擴大到2028年的904億美元

短期內，PCB市場將主要由以下應用驅動：

- 人工智慧和高速運算：先進的GPU、CPU和ASIC設備
- 汽車電子：電動車和 ADAS
- 通訊電子產品：高速網路和衛星（和 6G）無線通訊

PCB市場的成長將得到以下產品技術的支援：

- 高速高頻板和材料：用於伺服器、人工智慧、有線和無線基礎設施主板
- HDI 任意層：用於穿戴式裝置等

區域生產轉型：

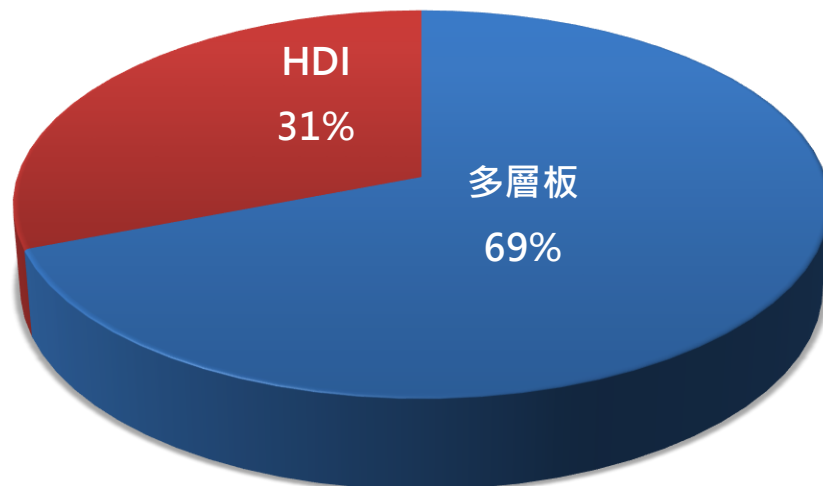
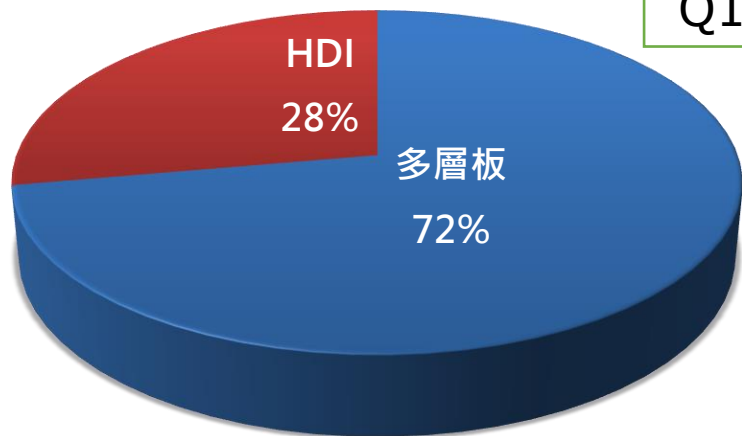
- 中國仍將是領先的PCB生產地，但將專注於產品的附加價值和在地化，此外，整合可能會發生。
- 東南亞將成為多層板、HDI、軟板和載板的新興且不斷成長的生產基地。幾年後，東南亞可能成為世界第二大生產基地。
- 日本、台灣、韓國將更依賴載板的生產。
- 美洲和歐洲市場將得到軍事、工業和醫療方面PCB生產的支持。

2024年第二季 營運概況

2024年第二季 銷售分析-技術別

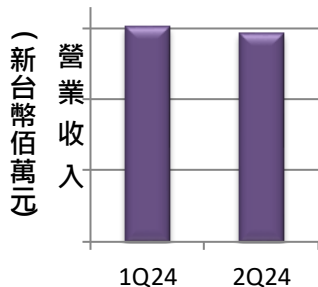
Q2

Q1



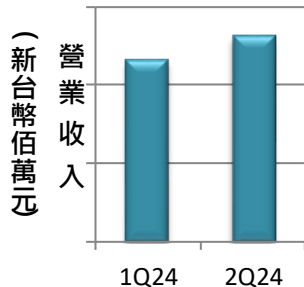
多層板

季變化 - 3%

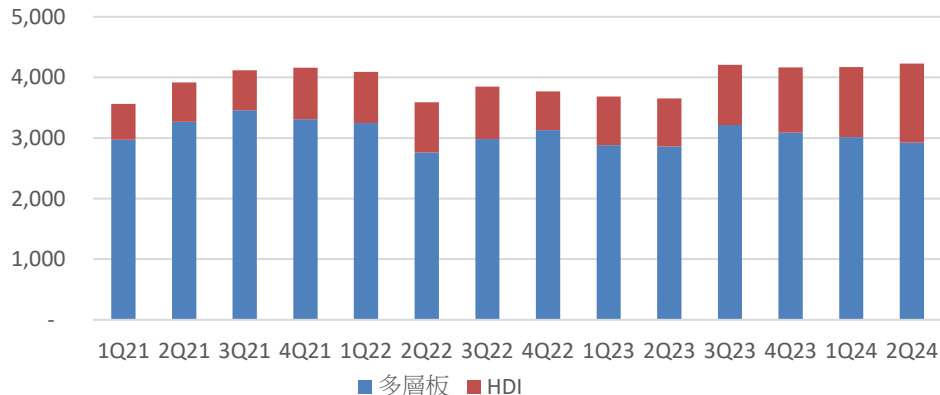


HDI

季變化 + 13%



技術別之營業收入



合併損益表

綜合損益表項目 (新台幣億元)	2Q24	1Q24	單季 季變化%	2Q23	單季 年變化%	Q1-Q2 2024	Q1-Q2 2023	累積 年變化%
營業收入淨額	42.28	41.71	1.4 %	36.54	15.7 %	83.99	73.39	14.4 %
營業毛利率	27.4 %	22.7 %	4.8 %	20.0 %	7.5 %	25.1 %	19.9 %	5.2 % pts
營業費用	6.11	5.53	10.4 %	5.13	19.0 %	11.64	10.19	14.2 %
營業淨利率	13.0 %	9.4 %	3.6 %	5.9 %	7.1 %	11.2 %	6.0 %	5.2 % pts
營業外收入及支出	(0.20)	0.18	210.9 %	1.06	118.5 %	(0.02)	0.15	112.9 %
本期淨利	3.40	2.83	20.4 %	2.36	43.9 %	6.23	3.32	87.6 %
純益率	8.0 %	6.8 %	1.3 %	6.5 %	1.6 %	7.4%	4.5 %	2.9 % pts
每股盈餘(元)	1.23	1.02	20.6 %	0.85	44.7 %	2.24	1.20	86.7 %
股東權益報酬率	18.4 %	16.2 %	2.2 %	15.4 %	3.1 %	16.9 %	10.8 %	6.1 % pts
平均匯率	31.90	31.45	1.4 %	30.55	4.4 %	31.90	30.55	4.4 %

* 2024年第二季加權平均流通在外股數為277,675仟股

** 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據

合併資產負債表及重要財務指標 〈 集團 〉

資產負債表項目 (新台幣億元)	2Q24		1Q24		2Q23	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及有價金融商品投資	43.28	16.2%	41.72	17.1%	30.49	15.0%
應收帳款	45.54	17.0%	45.43	18.6%	38.57	18.9%
存貨	27.35	10.2%	24.05	9.9%	22.23	10.9%
不動產、廠房及設備	134.09	50.2%	116.67	47.9%	97.24	47.7%
資產總計	267.36	100.0%	243.72	100.0%	203.71	100.0%
流動負債	143.97	53.8%	118.46	48.6%	88.23	43.3%
長期計息負債	33.58	12.6%	40.70	16.7%	42.41	20.8%
負債總計	193.47	72.4%	174.04	71.4%	142.11	69.8%
股東權益總計	73.89	27.6%	69.68	28.6%	61.60	30.2%
重要財務指標						
平均收現日數	106		107		105	
平均銷貨日數	76		70		82	
流動比率(倍)	0.9		1.0		1.1	
資產生產力(倍)	0.7		0.7		0.7	

註 資產生產力= 銷貨淨額/ 平均資產總額。

合併現金流量表

(新台幣億元)	2Q24	1Q24	2Q23
期初現金	41.72	33.75	30.85
營業活動之淨現金流入(出)	5.41	4.64	7.63
資本支出	(16.55)	(15.10)	(6.53)
現金股利	0.00	0.00	0.00
銀行借款	15.04	15.31	0.52
投資與其他	(2.45)	2.63	0.45
期末現金	43.28	41.72	30.49
自由現金流量	(11.14)	(10.46)	1.10

註 自由現金流量=營業活動之淨現金流入(出)-資本支出

2024Q2總結

- 以產品別占比來看，汽車板占比減少3%，網路通訊及服務器產品占比增加2%，顯示面板占比增加1%，其他產品別持平。
- 從技術別來看，HDI的占比達31%，較前一季提升3%，金額增長13%，產品結構持續優化。
- 第二季的營收為42.28億，較前一季增加1.4%。毛利率為27.4%，增加4.8個百分點，主要原因是HDI產品占比持續提升，汽車、網通、顯示面板都有高階新產品加入量產，以及稼動率維持高檔等因素。
- 營業費用率為14.4%，較前一季增加1.1個百分點，主要是因應泰國廠提前在第三季量產，導致營業費用(主要是人事費用)提前發生。
- 營業淨利率為13%，較前一季增加3.6個百分點。
- 營業外收入及支出為-2,000萬元，匯兌收益約4,200萬元，主因人民幣及台幣貶值。
- 本期淨利為3.4億元，較前一季增加20.4%。純益率為8%，較前一季增加1.3個百分點。每股盈餘 (EPS) 為1.23元，較前一季增加20.6%，上半年較去年同期增加86.7%。

未來展望

未來展望

- 第三季客戶需求溫和成長，HDI趨勢往上。配合客戶需求，黃石二廠高階HDI產能逐月開出，因客戶產品更為高階，新增產能修訂為15萬SF，但全產全銷的營收貢獻不變。預計為第三季營收帶來中高個位數的季成長，但仍視客戶拉貨狀況而定。
- 毛利率方面，產品組合優化為正向影響。但泰國廠開始量產，預估短期對毛利率會有一些影響，但影響範圍相對有限。我們仍對長期毛利率保持信心，並且新技術和新廠房的投產將逐步提升我們的營運績效和市場競爭力。
- 第三季營業費用率預估持平或稍微上升，主要是因為泰國廠剛開始營運所致。一旦泰國工廠的營運步入正軌並產生營收貢獻，整體的營業費用率將會下降。
- 第三季預估汽車、網路通訊及服務器、儲存裝置、電腦及周邊都有成長。其中，網路通訊及服務器產品類型中，網通卡繼續積極放量，AI ASIC加速卡也已通過認證，目前小量生產中。這些產品多為高階HDI的設計，對獲利有正向的貢獻。
- 泰國廠提前至第三季量產，產能逐月開出，並接受客戶稽核。
- 依目前客戶需求來看，2024下半年會優於上半年，2025年我們持樂觀正向的看法，但仍取決於整體經濟情況。

定穎在ESG的作為

定穎完成TNFD(自然相關財務揭露)評估

TNFD揭露建議，旨在協助企業評估和揭露與自然相關的風險，如氣候變化、生態系統崩潰和生物多樣性損失等，同時使投資人與企業更好地理解自然風險將如何影響其業務，並促使企業採取更永續的經營模式。



詳細內容請參閱定穎2023 ESG 永續報告書。

2024Q2 ESG 行動與績效

2024Q2 其他 ESG 行動與績效包括：

- 完成桃園、昆山、黃石三地2023年的溫室氣體盤查，包括範疇一、二、三。
- 超穎參與電-碳-金融申請綠電量4960萬千瓦時，預估今年綠電占總用電量可達33.3%，可減少二氧化碳排放量57,232噸。
- 超穎榮獲省級綠色供應鏈管理企業。
- 超穎榮獲湖北五一勞動獎狀。
- 超穎捐贈黃金山小學電腦設備。
- 超穎UL2799廢棄物零填埋最高級鉑金級續證。



Q&A